

# 江苏省半导体行业协会

---

## 江苏省半导体行业协会关于公开征求 《晶圆级扇出封装外形尺寸》等 3 项团体标准意见的通知

尊敬的各相关单位及专家：

由华进半导体封装先导技术研发中心有限公司等单位参与起草的《晶圆级扇出封装外形尺寸》、《堆叠封装上封装体外形尺寸》、《堆叠封装下封装体外形尺寸》等 3 项团体标准已完成征求意见稿，现公开征求意见。诚挚邀请各相关单位和专家对上述标准提出宝贵意见和建议（标准征求意见稿和编制说明请见附件）。

征求意见的截止时间为 2021 年 9 月 30 日。请各有关单位和专家在截止日期之前将意见填入“团体标准意见反馈表”（见附件），以 E-mail 形式发送至联系人。逾期未回复将按无异议处理。

联系人：王瑞娟

联系电话：13921178425

Email：ruijuanwang@ncap-cn.com

